

# 2024深圳电子元器件展会(电阻,电容,电感,电位器)

产品名称	2024深圳电子元器件展会(电阻,电容,电感,电位器)
公司名称	FCE展览
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	15989233176

## 产品详情

2024深圳国际电子元器件展览会

2024 Shenzhen International Electronic Components Expo

时间：2024年4月9-11日

地点：深圳会展中心(福田)

展位预定：徐妍（手机号看联系栏）

指导单位

工业和信息化部

深圳市人民政府

主办单位

赛艾特会展(深圳)有限公司

中国电子器材有限公司

中电会展与信息传播有限公司

深圳市博远国际展览有限公司

组织单位

## 展会介绍

近年来，中国电子工业持续高速增长，带动电子元器件产业强劲发展。我国许多门类的电子元器件产量已稳居全球第1位，电子元器件行业在国际市场上占据很重要的地位。我国已经成为扬声器、铝电解电容器、显像管、印制电路板、半导体分离器件等电子元器件的世界生产基地。国内外电子信息产业的迅猛发展给上游电子元器件产业带来了广阔的市场应用前景。汽车电子、PDA、互联网应用产品、机顶盒等产品的迅速启动及飞速发展，将极大地带动中国电子元器件市场的发展。在通讯类产品中，移动通信、光通信网络，普通电话等都需要大量的元器件。另外，计算机及相关产品、消费电子产品等领域的需求依然强劲，这些都将成为中国电子元器件市场发展的动力。基于市场需求的新特点，电子元器件正在向超微化、片式化、数字化、智能化、绿色化发展方向，中国电子元器件行业发展前景乐观。

电子元器件产业作为电子信息产业的基石，全面应用到各个传统与新兴应用领域，国家持续出台相关政策助力电子元器件产业高速发展。2021年初，工信部印发了《基础电子元器件产业发展行动计划（2021—2023年）》，明确了将面向智能终端、5G、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场，推动基础电子元器件产业实现突破。到2023年，我国电子元器件销售总额达到2.1万亿元，力争15家企业营收规模突破100亿元，基础电子元器件产业将迎来新的发展机遇。

为促进电子元器件行业新产品、新技术、新材料、新工艺及新装备的推广应用与经贸交流，2024深圳国际电子元器件展览会将于2024年4月9-11日在深圳会展中心盛大举办，展会隶属于第十二届中国电子信息博览会专题展之一，专注于为电子元器件企业品牌推广、产品展示、交流合作提供一站式解决方案平台，助力企业实现全产业链的交流和互通。作为兼具规模和影响力的电子元器件产业品牌盛会，展会遵循市场发展趋势，给电子元器件行业创造提升品牌度和开拓市场的一个契机。充分发挥其传递市场信息与交流技术的窗口作用，把脉行业发展方向。共享国际化大平台，共拓电子元器件大市场，让我们携手同行，共创商机！

## 展品范围

电阻、电容、电感、电位器、电子管、散热器、机电元件、连接器、半导体分立器件、电声器件、激光器件、电子显示器件、光电器件、传感器、电源、开关、微特电机、电子变压器、继电器、印制电路板、集成电路、各类电路、压电、晶体、石英、陶瓷磁性材料、印刷电路用基材基板、电子胶(带)制品、电子功能工艺专用材料、特种电子元器件、电子材料、电子化学品等。

## 展会优势

高效供需对接平台——超10,000+的全产业链电子元器件行业相关观众将赴展会现场与国内外品牌实现对接。

同期展会——CITE 2024第十二届中国电子信息博览会是展示全球电子信息产业新产品和技术的平台，经过十一年努力，现已经成为亚洲规模大、产业链全、活动内容丰富、影响力提升快的电子信息展览会，也是行业具有国际影响力的电子信息行业年度盛会。

全媒体渠道曝光——包含百度、360搜索、神马搜索、搜狗搜索四大搜索引擎，微信公众号、微博、搜狐、头条等自媒体平台，DOUYIN、微信视频号、腾讯、爱奇艺等视频资源全媒体主要平台推广曝光，为品牌提高度，加速品牌从同行中脱颖而出。

## 展会亮点

科技协同创新：发挥粤港澳大湾区城市群效应，为产业链打造创新升级环境，实现从“世界工厂”向“广东创造”转变，建设成新一代电子元器件产业集群；实现科技与产业经济与地域经济的相促进。

发掘产业趋势，共铸市场先机：把握电子元器件产业协同创新要求高、产值体量大、涉及范围广等特点，积极贯彻落实“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，促进中国企业与“一带一路沿线”和发展中国家进行高效的产品流通和输出、共享优势产能，共谋合作发展。

集合消费电子科技产品：汇聚海内外电子元器件产业中高新技术企业及各类高新技术产品集中展示，为各方创造项目合作、品牌建设、技术引导及投融资对接机会。

营造科技应用场景体验，引爆新传播潮流：突破传统展览闭环，导入市场新传播矩阵，沉浸式观展体验，同期热点营造话题引爆。

欢迎业界同仁踊跃报名参展CITE-ELE

2024，现正接受申请，请速与我们联系，索取参展合同及展位平面图！

知识科普：

系统级芯片形成或产生过程包含以下三个方面：

1) 基于单片集成系统的软硬件协同设计和验证;

2) 再利用逻辑面积技术使用和产能占有比例有效提高即开发和研究IP核生成及复用技术，特别是大容量的存储模块嵌入的重复应用等；IP核复用技术在SoC芯片设计中被广泛采用。先进工艺条件下，SoC系统级芯片设计规模越来越大，芯片上所集成的IP种类和数量也随之暴增。IP数据如何高效管理和追踪变得尤为重要。

3) 超深亚微米(VDSM)、纳米集成电路的设计理论和技术。